

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-15

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（网络会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	东北证券、长城基金（因采取网络会议形式，参会者未签署书面调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。）
时间	2024年8月19日 10:00-11:00
地点	广州广合科技股份有限公司会议室
公司接待人员	副总经理、董事会秘书：曾杨清 证券事务代表：陈炜亮、黄淑芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2024年上半年经营情况：</p> <p>2024年上半年，公司实现营业收入约170,558.35万元，同比增长45.50%，实现归属于上市公司股东的净利润31,938.71万元，同比增长102.42%。</p> <p>2024年第二季度，公司实现营业收入约92,122.60万元，环比增长17.45%，实现归属于上市公司股东净利润17,430.10万元，环比增长20.14%。</p> <p>2024年上半年，公司积极应对全球供应链调整、汇率波动、原材料价格波动等外部环境带来的挑战，坚持</p>

以技术创新、产品迭代驱动公司发展，持续加大技术研发和创新投入，提高产品的附加值和竞争力，取得丰硕的成果。同时，受上半年行业订单需求回暖影响，公司紧跟市场需求，积极开拓业务，各厂产能利用率均有提升，实现业绩稳定增长。

2024年上半年，公司 EGS 平台服务器产品出货占比继续提升，BHS 和 Turin 平台以及交换机产品完成小批量出货，同时公司启动了 Oak 平台和 Venice 平台样品的试制。全面参与客户 UBB、I/O 等 AI 产品的量产项目，报告期内公司加大了 PCIe 交换板和 OAM 板的开发力度，进一步提升高端产品占比。在产能建设方面，公司积极推动广州一厂 HDI 能力提升，以应对当前的 BMC 及加速卡的需求。同时为加大海外市场开拓力度，满足海外客户全球供应链调整的需求，公司泰国生产基地建设按计划快速推进，预计明年一季度实现规模量产。

报告期内，公司把握行业结构性机会，继续加大业务拓展力度，产能稼动率保持在良好水平，同时伴随 AI 加速演进及应用上的不断深化，以及通用服务器迭代升级，拉动公司产品结构持续优化，公司 2024 上半年的营收和净利润较上年同期均有所增长。公司所处行业需求稳定，经营业绩稳步提升。

二、行业及服务器市场业务情况：

进入 2024 年，PCB 需求有所好转，行业修复明显，主要得益于 AI 及汽车电子领域需求保持高位，同时下游

消费电子等领域需求亦有改善。

从中长期看，AI 推动的下游需求增长将继续拉升高频高速板、HDI 板、IC 载板等高端 PCB 需求，成为 PCB 增长的主要动力。预计封装基板、HDI 板、18 层及以上的高多层板等高端产品仍将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为 8.80%、7.10%、10.00%。

公司着力深耕于高速 PCB 领域的研究，形成了以服务器 PCB 业务为主，消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域 PCB 为辅的业务结构。未来公司仍将聚焦服务器 PCB 主航道，围绕企业所制定的“云、管、端”发展战略，重点对 PCIe6.0 服务器、AI 服务器、新一代路由交换机、6G 基站、5.5G 低轨通讯、AI 电脑、自动驾驶、高清显示、新能源等领域组织技术研发和产品开发。在巩固服务器用 PCB 市场地位的同时，也积极拓展通信设备以及智能终端设备的 PCB 产品市场。通过完善产品结构，优化技术能力布局，提高市场竞争力和盈利能力。

在产能建设方面，公司积极推动广州一厂 HDI 能力提升，以应对当前的 BMC 及加速卡的需求。

三、公司泰国基地进展情况

为加大海外市场开拓力度，满足海外客户全球供应链调整的需求，在泰国投资建设工厂，设计满产年销售约 20 亿元。公司泰国生产基地建设按计划快速推

	<p>进，预计明年一季度实现规模量产。</p> <p>四、公司 2024 年上半年技术研发成果</p> <p>NPI 制造能力:形成板厚 5.7mm, 钻刀 0.2mm 的钻孔、电镀、除胶等能力，推动 800G 光模块，800G 交换机、AI 7 阶 HDI 的样品制作，完成 4 阶 BMC 的 NPI 制作，实现 M8 级材料的量产加工能力；</p> <p>在材料研究方面:已经覆盖高速 SULL (M8 级材料量产，M9 级材料预研)。</p> <p>注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 19 日